

歷史、發展及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯至2015年5月，當時本公司由合肥建投響應合肥市政府倡議與力晶創新投資控股股份有限公司（「力晶創投」）達成技術合作下成立。經歷逾十年發展，我們已成為領先的12英寸純晶圓代工企業，為全球客戶提供晶圓代工服務。憑藉專有技術及研發能力，我們的技術平台覆蓋從150nm至28nm的技術節點。根據弗若斯特沙利文的資料，於2024年，以營業收入計，我們是全球第九大、中國大陸第三大晶圓代工企業。

於2020年11月，本公司改制為股份有限公司。於2023年5月，本公司於上海證券交易所科創板上市（證券代碼：688249）。

業務發展里程碑

下表概述我們業務發展的關鍵里程碑：

年份	里程碑
2015年	本公司於中國成立。
2017年	A1製造工廠投產。 110nm DDIC開始量產。 我們取得ISO9001質量管理體系認證。
2018年	大面板DDIC開始量產。 我們通過ISO14001環境安全及健康管理體系認證。 我們順利完成首顆觸控與顯示驅動集成芯片試產。 12英寸晶圓每月產能達10,000片。
2019年	12英寸晶圓累計出貨量超過100,000片。
2020年	本公司首次獲得高新技術企業認證。
2022年	按收入計，年收入超過人民幣100億元，我們位列全球前十大晶圓代工企業。 我們開始量產55nm DDIC
2023年	本公司於上海證券交易所科創板上市（證券代碼：688249）。
2024年	我們實現DDIC、CIS、PMIC、Logic IC及MCU等主要產品類別介乎150nm至55nm平台量產。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
	28nm邏輯芯片平台通過功能性驗證並成功點亮電視面板。
	本公司獲《科創板日報》評選為2024年度最具創新力科創板上市公司。
2025年	40nm高壓OLED DDIC、55nm全流程堆棧式CIS及55nm Logic IC產品均導入量產。

我們的主要附屬公司

本公司及其附屬公司共同進行我們的業務運營。下文載列截至最後實際可行日期主要附屬公司的資料。

合肥新晶

合肥新晶於2021年8月24日在中國成立為有限公司。自成立以來，合肥新晶一直為我們的附屬公司。該公司現時運營我們的A2製造工廠，主要從事集成電路芯片及產品的製造及銷售。截至最後實際可行日期，合肥新晶由本公司全資擁有。

合肥皖芯

合肥皖芯於2022年12月15日在中國成立為有限公司。於2024年4月，我們認購合肥皖芯的新增註冊資本，使合肥皖芯成為本公司的附屬公司。^{附註}有關詳情，見下文「收購事項」。該公司現時運營我們的A3製造工廠，主要從事集成電路芯片及產品的製造及銷售。截至最後實際可行日期，合肥皖芯由本公司擁有約33.75%權益，由合肥建投擁有22.85%權益及由15名投資者擁有43.4%權益，該15名投資者持股量介乎約0.16%至8.04%，且除投資於合肥皖芯外，均為獨立第三方。鑒於我們的董事會對合肥皖芯擁有控制權，合肥皖芯以本公司附屬公司入賬。因此，合肥皖芯由本公司最終控制。有關進一步詳情，見附錄一所載的會計師報告。

晶合日本

晶合日本於2017年8月18日根據日本法律成立。晶合日本自成立以來一直是我們的附屬公司。其主要從事集成電路芯片及產品的設計、研究及開發。截至最後實際可行日期，晶合日本由本公司全資擁有。

附註：

於我們投資前，合肥皖芯由合肥晶策企業管理有限公司（「合肥晶策」）作為普通合夥人控制，而合肥晶策由本集團僱員兼合肥皖芯董事曹宗野先生控制。合肥皖芯在我們投資前並無開展業務，但自此快速擴張。

歷史、發展及公司架構

公司發展

本公司的早期發展

於2015年5月，本公司根據中國法律成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣10,000,000元。成立時，本公司由合肥建投全資擁有。

於2020年9月前多輪股本變更完成後，本公司註冊資本增加至人民幣1,504,601,368元。

於2020年11月，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司，註冊資本為人民幣1,504,601,368元，本公司股權架構如下：

股東	股份數目	概約持股 百分比 (%)
合肥建投 ⁽¹⁾	468,474,592	31.14
合肥芯屏 ⁽¹⁾	328,736,799	21.85
力晶創投 ⁽²⁾	412,824,208	27.44
其他股東 ⁽³⁾	294,565,769	19.58
合計	1,504,601,368	100

附註：

- (1) 合肥芯屏由建投資本作為普通合夥人控制，而建投資本則於合肥芯屏持有0.04%合夥權益。建投資本主要從事投資管理及資產管理，由合肥建投控制。由於建投資本作為普通合夥人管理合肥芯屏的合夥事務，並控制其投資決策委員會（負責其決策）所有成員的組成，故建投資本能夠控制合肥芯屏。截至最後實際可行日期，建投資本由合肥建投及合肥德軒投資管理有限公司（「合肥德軒」）分別擁有約70.83%及29.17%權益。合肥建投由合肥市人民政府國有資產監督管理委員會全資擁有。

合肥芯屏由合肥建投、合肥瀚和投資合夥企業（有限合夥）（「合肥瀚和」）及合肥瀚屏投資合夥企業（有限合夥）（「合肥瀚屏」）作為其有限合夥人分別擁有47.44%、42.29%及10.23%權益。合肥瀚和及合肥瀚屏各自為合肥建投的附屬公司，並為合肥德軒作為普通合夥人管理的私募股權基金，分別持有其0.18%及0.3%股權。合肥瀚和及合肥瀚屏的有限合夥人為合肥建投，截至最後實際可行日期持有其99%以上合夥權益。由於合肥瀚和及合肥瀚屏完全由合肥建投控制，作為有限合夥人並無參與合肥芯屏的管理或決策，且僅享有合肥芯屏的被動經濟權益，故合肥瀚和及合肥瀚屏不被視為本公司的控股股東。

合肥德軒是一名資產管理人及基金管理人。截至最後實際可行日期，合肥德軒由獨立第三方王友軍及合肥建投最終控制51%及49%權益。王友軍是一名私人投資者，與合肥建投共同投資合肥德軒，其後共同投資建投資本及合肥芯屏，並隨後擔任建投資本的董事兼總經理。除本文所披露者外，王友軍並無於控股股東組別內擔任任何其他管理職位，且獨立於本公司及控股股東組別。

- (2) 力晶創投為於中國台灣成立的股份有限公司，主要從事投資控股並於臺灣證券交易所上市（股票代號：5346）。根據力晶創投2024年年報，截至2025年4月19日，力晶創投的最大股東為黃崇仁，持有其4.75%股權。

歷史、發展及公司架構

- (3) 在該等股東中，員工持股平台均為於中國成立的有限合夥企業，合共持有22,162,070股股份，相當於轉換完成後已發行股份總數約1.47%。各員工持股平台均由合肥晶策(作為普通合夥人)控制，而合肥晶策則由本集團僱員兼合肥皖芯董事曹宗野先生控制。

於上海證券交易所上市

於2023年5月，我們完成A股於上海證券交易所科創板上市(證券代碼：688249) (「A股上市」)。A股上市中，我們發行合共501,533,789股A股(相當於A股上市後本公司經擴大股本的25%)。作為A股上市的一部分，我們進行戰略配售，據此(其中包括)：20,288,464股A股(相當於A股上市完成後股本總額的1.01%)分配予員工持股計劃，該等計劃為專業資產管理人中國國際金融股份有限公司以全權委託方式管理及控制的集合資產管理計劃。有關員工持股計劃為對本集團長期發展充滿信心的本集團若干董事、高級管理層成員及主要員工認購該等A股。

截至最後實際可行日期，本公司股權架構載列如下：

股東	A股數目	概約持股百分比
		(%)
合肥建投 ⁽¹⁾	468,474,592	23.34
合肥芯屏 ⁽¹⁾	328,736,799	16.37
力晶創投	262,364,072	13.07
華勤技術股份有限公司(「華勤技術」) ⁽²⁾ . . .	120,368,109	6.00
其他A股股東 ⁽³⁾	827,648,125 ⁽⁴⁾	41.22
合計	2,007,591,697	100

附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，合肥建投控制本公司已發行股本總額約39.71%，包括直接擁有23.34%及透過合肥芯屏間接擁有16.37%，合肥芯屏的普通合夥人為建投資本，而建投資本則由合肥建投控制。有關更多詳情，見「與控股股東的關係」。
- (2) 華勤技術為於中國成立的股份有限公司，由非執行董事邱文生先生最終控制，為從事移動通信軟件及技術開發的全球智能產品平台企業。華勤技術於上海證券交易所上市(證券代碼：603296)。華勤技術持有的股份受截至2028年8月26日止禁售期承諾所規限。
- (3) 據董事所深知，截至最後實際可行日期，其他A股股東包括60,991名股東。
- (4) 包括截至最後實際可行日期已購回及於本公司股份購回賬戶中持有的62,088,500股A股。

歷史、發展及公司架構

收購事項

於2024年4月，本公司認繳合肥皖芯增加的註冊資本人民幣30百萬元，相當於合肥皖芯的60%股權。因此，合肥皖芯成為我們的附屬公司。在我們投資之前，合肥皖芯由合肥晶策作為普通合夥人控制，而合肥晶策則由本集團僱員兼合肥皖芯董事曹宗野先生控制。其後，合肥皖芯完成數輪股本變更。截至最後實際可行日期，本公司持有合肥皖芯的33.75%股權，鑒於我們對合肥皖芯擁有董事會控制權，合肥皖芯入賬列作我們的附屬公司之一。

合肥皖芯於我們投資前尚未開展業務，但其業務規模隨後於往績記錄期間有所增長。根據上市規則第4.05A條，於我們申請[編纂]之日，收購合肥皖芯將被分類為上市規則第十四章項下的主要交易。有關進一步詳情，見本文件附錄一會計師報告附註34。

此外，我們擬於往績記錄期間後進行若干投資。有關進一步詳情，見「豁免嚴格遵守上市規則—有關於往績記錄期間後將予收購股權的豁免」。

中國監管規定

據中國法律顧問告知，我們已就所有上述增資、資產轉讓及股權轉讓依法妥善完成、辦理及取得所有必要法律批准，並向中國相關政府部門完成所有必要政府登記。

於上海證券交易所上市及於聯交所[編纂]的原因

本公司現時於上海證券交易所科創板上市。董事確認，且中國法律顧問認為，截至最後實際可行日期，我們概無嚴重違反上海證券交易所規則以及中國其他適用證券法律及法規的情況，且據董事在作出一切合理查詢後所深知，概無任何有關上海證券交易所合規記錄的重大事項應提請投資者垂注。根據獨家保薦人進行的獨立盡職審查，獨家保薦人並無發現任何事宜以致其不同意董事就本公司於上海證券交易所科創板合規記錄所作確認。

本公司尋求於聯交所[編纂]，旨在支持業務發展、提升整體競爭力及品牌認知度，並鞏固我們的行業地位。有關更多詳情，見「業務—我們的戰略」及「未來計劃及[編纂]用途」。

公眾持股量及自由流通量

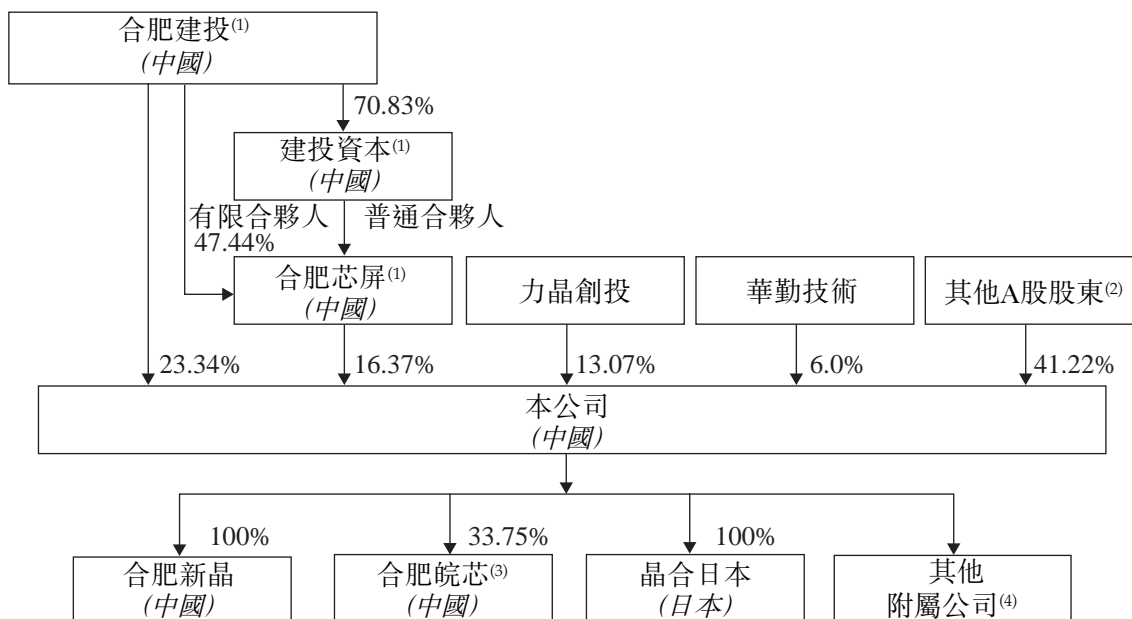
我們的A股於上海證券交易所上市。根據[編纂]將予發行的H股總數佔本公司已發行股本總額約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)(不包括本公司截至最後實際可行日期購回作為庫存股的62,088,500股A股)。緊隨[編纂]完成後，預期將由公眾持有的H股總市值將超過[編纂]港元(按指示性[編纂]範圍[編纂]港元至[編纂]港元的下限計算)，高於上市規則第19A.13A(2)(b)條項下規定須由公眾持有的H股預期市值不少於3,000,000,000港元，故符合上市規則第19A.13A條。

歷史、發展及公司架構

按[編纂]每股H股[編纂]港元(即指示性[編纂]範圍的下限)計算，本公司將符合上市規則第19A.13C條項下的自由流通量規定。

公司架構

下圖載列緊接[編纂]前(假設於最後實際可行日期至[編纂]期間已發行股本概無變動)的簡化公司架構：



附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，合肥建投控制本公司已發行股本總額約39.71%，包括直接擁有23.34%及透過合肥芯屏間接擁有16.37%，合肥芯屏的普通合夥人為建投資本，而建投資本則由合肥建投控制。因此，合肥建投、建投資本及合肥芯屏構成一組控股股東。有關更多詳情，見「與控股股東的關係」。
- (2) 包括截至最後實際可行日期已購回及於本公司股份購回賬戶中持有的62,088,500股A股。據董事所深知，除力晶創投及華勤技術外，截至最後實際可行日期，概無其他A股股東持有我們已發行A股總數5%以上。有關力晶創投及華勤技術持股的更多詳情，見上文「公司發展」。
- (3) 截至最後實際可行日期，合肥皖芯約22.85%及43.4%餘下權益分別由合肥建投及15名投資者(即工融金投(北京)新興產業股權投資基金合夥企業(有限合夥)、農銀金融資產投資有限公司、建信金融資產投資有限公司、中銀金融資產投資有限公司、交銀金融資產投資有限公司、中國中信金融資產管理股份有限公司、杭州光曜致新同鴻企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)、安徽徽元中小企業發展基金合夥企業(有限合夥)、安徽交控招商產業投資基金(有限合夥)、安徽交控招商信息新基建私募基金合夥企業(有限合夥)、安徽鐵基皖芯企業管理中心(有限合夥)、安徽徽元新站股權投資合夥企業(有限合夥)、安徽國元產業轉型升級投資基金合夥企業(有限合夥)、安徽交控交匯新基建股

